多芯片组件 MCM 技术及其应用



作者: 杨邦朝, 张经国主编

出版社:成都:电子科技大学出版社

出版日期: 2001.08

总页数: 653

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10497128.html) 查找全本阅读方式

多芯片组件 MCM 技术及其应用 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/1049 7128.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10497128.html

书名: 多芯片组件 MCM 技术及其应用